

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2025-034

盛美半导体设备（上海）股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件
修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案已由第二届董事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会、第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十六次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过。

公司根据最新情况，于 2025 年 5 月 20 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》等相关议案。

本次拟对向特定对象发行股票预案及相关文件进行相应修订，除修订了本次发行相关事项已履行和尚需履行的决策程序外，其他修订具体情况如下：

一、《盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新列示审议本次向特定对象发行股票的相关事项的董事会、股东大会； 2、更新本次发行的股数上限； 3、更新本次发行的募集资金金额以及各募投项目的投入

		金额
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司基本信息
	四、（五）发行数量	更新本次发行的股数上限
	四、（七）募集资金投向	更新本次发行的募集资金金额以及各募投项目的投入金额
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新公司总股本、本次发行的股数上限以及发行后控股股东持股比例的测算情况
	八、本次发行方案已取得的批准以及尚需呈报批准程序	更新列示审议本次向特定对象发行股票的相关事项的董事会、股东大会
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新本次发行的募集资金金额以及各募投项目的投入金额
	二、（一）研发和工艺测试平台建设项目	1、根据 2024 年数据，更新公司研发人员数量及学历情况 2、更新“研发和工艺测试平台建设项目”的募集资金投入的金额
	二、（二）高端半导体设备迭代研发项目	1、更新 2024 年度公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比增长率； 2、更新公司专利相关的数据
	二、（三）补充流动资金项目	更新 2024 年度公司营业收入同比增长率
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、（一）对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素	1、更新公司应收账款、存货、汇兑收益、毛利率、资产总额数据； 2、新增公司及部分子公司被列入“实体清单”的风险
	六、（二）可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素	更新本次发行的股数上限
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金股利分配情况	更新公司最近三年现金分红情况
第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	1、更新公司本次发行的募集资金总额； 2、根据 2024 年财务数据和发行方案更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提以及对公司主要财务指标的影响分析
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新公司在人员、技术、市场储备情况的相关数据和表述

二、《盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告（二次修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
五、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	五、（一）本次发行符合《公司法》、《证券法》相关规定	更新列示审议本次向特定对象发行股票的相关事项的董事会、股东大会
	五、（四）公司本次向特定对象发行股票符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“证券期货法律适用意见第 18 号”）的相关规定	更新本次发行的募集资金总额
	五、（五）本次发行程序合法合规	更新列示审议本次向特定对象发行股票的相关事项的董事会、股东大会
六、本次发行方案的公平性、合理性	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新列示审议本次向特定对象发行股票的相关事项的董事会、股东大会
七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	七、（一）本次发行对公司主要财务指标的影响	根据 2024 年财务数据和发行方案更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提以及对公司主要财务指标的影响分析
	七、（四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新公司在人员、技术、市场储备情况的相关数据和表述

三、《盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
一、本次募集资金使用计划	一、本次募集资金使用计划	更新本次发行的募集资金金额以及各募投项目的投入金额
二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	二、（一）研发和工艺测试平台建设项目	1、更新公司研发人员数量及学历情况； 2、更新“研发和工艺测试平台建设项目”的募集资金投入的金额

	二、（二）高端半导体设备迭代研发项目	1、更新 2024 年度公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比增长率； 2、更新公司专利相关数据
	二、（三）补充流动资金项目	更新 2024 年度公司营业收入同比增长率

四、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
一、本次发行对公司主要财务指标的影响	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	1、根据 2024 年财务数据和发行方案更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提以及对公司主要财务指标的影响分析； 2、更新本次发行的股数上限
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	四、（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新公司在人员、技术、市场储备情况的相关数据和表述

五、《盛美半导体设备（上海）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
二、项目方案概述及必要性、可行性分析	二、项目方案概述及必要性、可行性分析	更新本次发行的募集资金金额以及各募投项目的投入金额
	二、（一）研发和工艺测试平台建设项目	1、更新公司研发人员数量及学历情况； 2、更新“研发和工艺测试平台建设项目”的募集资金投入的金额；
	二、（二）高端半导体设备迭代研发项目	1、更新 2024 年度公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比增长率； 2、更新公司专利相关数据
	二、（三）补充流动资金项目	更新 2024 年度公司营业收入同比增长率

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2025年5月22日